上海硅产业集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

**股票名称：沪硅产业 股票代码：688126**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | 🗹特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 🗹电话会议 |
| **参与单位/个人** | 中泰、海通、国信、中信、方正、麦格里、浙商、长江等机构和个人投资者通过电话和网络参加会议。 |
| **时间** | 2024年4月15日 |
| **地点** | 线上交流 |
| **公司接待人员** | 邱慈云、李炜、黄燕 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1、半导体行业和沪硅产业经营情况介绍  2023年，宏观经济环境整体继续呈现复杂多变的态势, 经济的疲软、市场需求动力的不足，也使得半导体行业周期下行的趋势未有明显改变。虽然2023年年末出现了一定的复苏迹象，但是库存完全消化仍需一定时间。公司2023年的业绩也受到了一定的影响。  从收入来看，2023年全年，公司实现营业收入31.90亿元，同比下降了11%。收入的下降，叠加公司持续扩产导致的前期投入和固定成本较大，以及研发费用的持续较大投入，使公司在2023年的利润指标也受到了严重影响。  新昇方面。2023年，我们一期30万片/月产线的生产及出货持续保持稳定，历史累计出货已超过1000万片。此外，我们还持续不断地在推进二期30万片/月产能的建设工作，到了23年底已形成15万片/月的新增产能，公司300mm半导体硅片总产能已达到45万片/月，并且在2023年12月当月实现单月满产。预计2024年底，我们将完成新增产能的全部建设工作，届时，公司300mm硅片产能将达到60 万片/月。除上述已有及正在进行建设的产能外，公司还于2023年12月与太原市签订《关于半导体硅片材料生产基地项目合作协议》，拟在太原投资建设“300mm半导体硅片拉晶以及切磨抛生产基地”，加快300mm半导体硅片的产能建设和技术能力提升，扩充产品种类，为进一步扩充公司产品组合、提升公司市场份额，巩固国内领先地位扩大优势。  新傲方面。至2023年底，公司现有200mm及以下抛光片、外延片合计产能超过50万片/月，SOI硅片合计产能超过6.5万片/月。在国内，新傲科技持续推进300mm高端硅基材料研发中试项目，以更好地满足射频等应用领域市场和客户需求，现已建成约6万片/年的300mm高端硅基材料试验线，并在积极开展关键技术研发、相关产品的工艺推广和市场开拓，交付给了多个客户高圧 SOI与RF SOI 的样片；外延业务方面，新傲科技也在结合新能源汽车和工业类产品需求持续成长的市场情况，与客户开展全方位合作，持续积极开拓IGBT/FRD产品应用市场。  在海外，子公司Okmetic在芬兰万塔的扩产项目也在按计划正常推进中，该项目将以满足日益增长的利基市场需求，巩固其在先进传感器、功率器件、射频滤波器及集成无源器件等高端细分领域的市场地位。  总体来说，虽然由于半导体产业处于周期性调整的大环境，公司2023年的经营业绩受到一定的影响，但是从长期来看，受新能源汽车、大数据以及人工智能等产业的快速发展驱动，我们认为，半导体行业中长期整体还是积极向好的。在此行业调整的阶段，作为企业本身，我们将持续修练好自己的内功，进一步加快各个业务板块的产能建设，坚持技术研发、新产品开发，积极寻求产业链上下游的互动合作，丰富自身的产品，满足客户的多样化需求。  2、投资者交流  问：下游客户端需求状况以及库存情况。  答：目前观察到市场情况有所稳定，尤其是在12寸产品方面有一些回升的迹象，但仍处于初期阶段。8寸产品的回暖还需进一步观察。目前有客户还处于消化库存阶段。  问：逻辑和存储领域的修复情况。  答：逻辑领域出现了更多的需求，并开始上升。存储领域还处于相对平稳的阶段。  问：毛利率变动的原因。  答：主要还是因为折旧的增加和市场需求不足导致的降价压力。  问：300mm IGBT的进展。  答：已在多个客户处得到认证，并已开始逐渐加量生产，目前已经进入小量的量产阶段。整体验证周期较长，上量是一个逐步的过程。  问：8寸产能利用率情况及ASP情况。  答：成熟产品的价格会略微下降。预计今年会相对稳定，可能会有小幅度下降。  问：300mm SOI产品的价格。  答：国际上有公布的价格。我们的量产价格可能会有所不同，具体情况要等到量产时候再确定，但目前国际上最大的厂家出货的价格应该会更高。  问：产品价格趋势。  答：随着产量增加，工业品的价格普遍下降是大势所趋，但不同地区和深度的社会情况会产生影响。总体来看，12英寸产品领域存在着5大家的垄断竞争格局，虽然在行业下行期间价格会有下降的压力，但随着业务的稳定完成，价格相对稳定的趋势将会体现。但是，一旦产能超过需求，价格恢复可能会面临一定的压力。  问：存储客户目前的情况。  答：目前看上去库存已经基本回到一个正常的水平，比较稳定。但要实现快速增长，可能要等到继续观察，客户要在持续开展认证工作。  问：研发布局情况。  答：正在研发许多新产品，其中包括已经发布的IGBT产品，但针对不同的客户和应用场景，都需要量身定制。此外，还在开展SOI方面的硅片衬底的开发。其他国内外市场的需求，也在持续关注和开展，公司将用快速研发能力来满足客户的需求。  问：8英寸的扩产计划。  答：芬兰Okmetic正在进行FAB2的建设工作，这将使Okmetic的产能增加一倍。对于这些特殊产品，我们拥有许多全球客户，需求仍然明显。  问：海外8英寸需求情况。  答：目前海外客户的库存还比较高，库存还在继续消化。  问：300mm扩产过程中的设备国产化情况。  答：已经使用了较多国产设备，国产化比例会大幅增加。但仍将保持与国外厂商的合作。  问：车规级产品的情况。  答：目前已经有车规级产品，比如说新傲科技的200mm厚外延，应用于IGBT和FRD产品。同时，也在积极拓展其他客户，争取将应用扩展到其他新能源领域。在300mm方面，也在积极开展相关工作。  问：受托加工业务下滑原因。  答：受托加工业务主要是200mm SOI产品，由于全球智能手机市场的不景气，导致2023年市场出现了较大的调整。尽管价格没有大幅下跌，但需求确实有所下降，尤其是手机市场。随着手机需求逐渐回暖，将有助于市场回升。 |
| **附件清单（如有）** |  |
| **日期** | 2024年4月15日 |